

**性能特点：**

- RF/LO 频段：3GHz~10GHz
- IF 频段：DC~4GHz
- 变频损耗：7dB
- RF-IF 隔离度：18dB
- LO-IF 隔离度：35dB
- LO-RF 隔离度：45dB
- 本振功率：17dBm
- 芯片尺寸：1.23mm×0.78mm×0.1mm

**产品简介：**

HH-MX787 是一种 GaAs MMIC 无源双平衡混频器芯片，射频/本振频率分别覆盖 3~10GHz，中频频率覆盖 DC~4GHz，变频损耗小于 8.5dB，射频到中频隔离度大于 16dB，本振到中频隔离度大于 32dB，本振到射频隔离度大于 42dB，典型本振输入功率为 17dBm。

**电参数：** (TA=25°C,IF=0.1GHz,LO=17dBm)

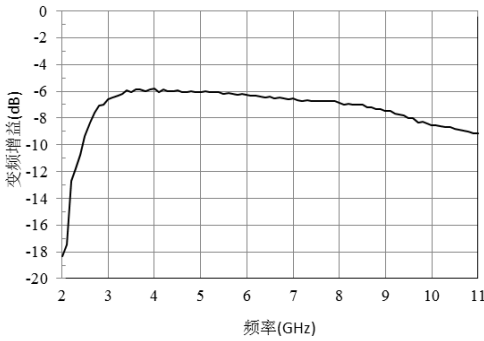
指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率	3~10			GHz
本振频率	3~10			GHz
中频频率	DC~4			GHz
变频损耗	6	7	8.5	dB
RF-IF 隔离度	16	18	25	dB
LO-IF 隔离度	32	35	37	dB
LO-RF 隔离度	42	45	55	dB
P1dB(input)	9	12	15	dBm

**使用限制参数：** (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

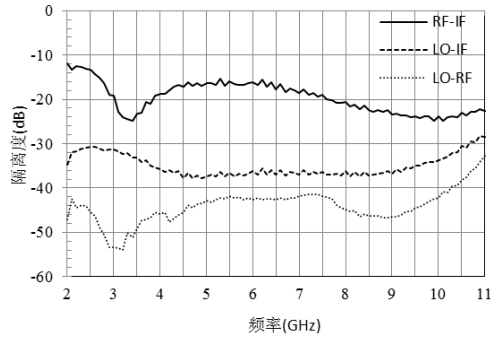
射频/中频功率	26dBm
本振功率	26dBm
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

典型曲线：

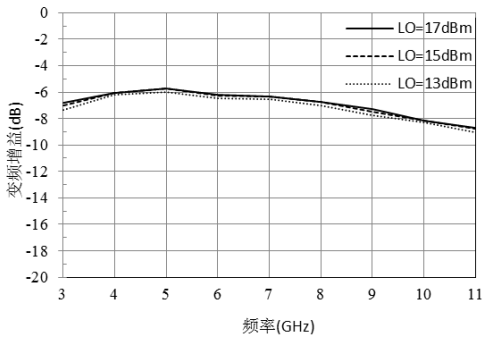
变频损耗@LO=17dBm,中频频率 0.1GHz



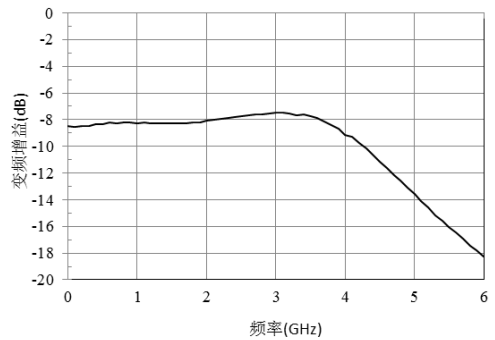
隔离度@LO=17dBm,中频频率 0.1GHz



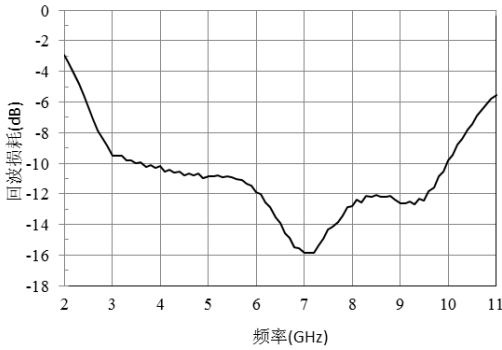
变频损耗@中频频率 0.1GHz



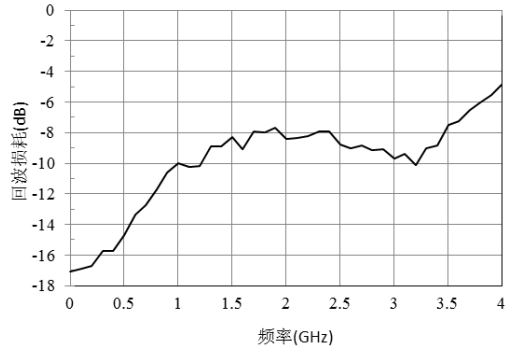
中频带宽@LO=10GHz,LO=17dBm



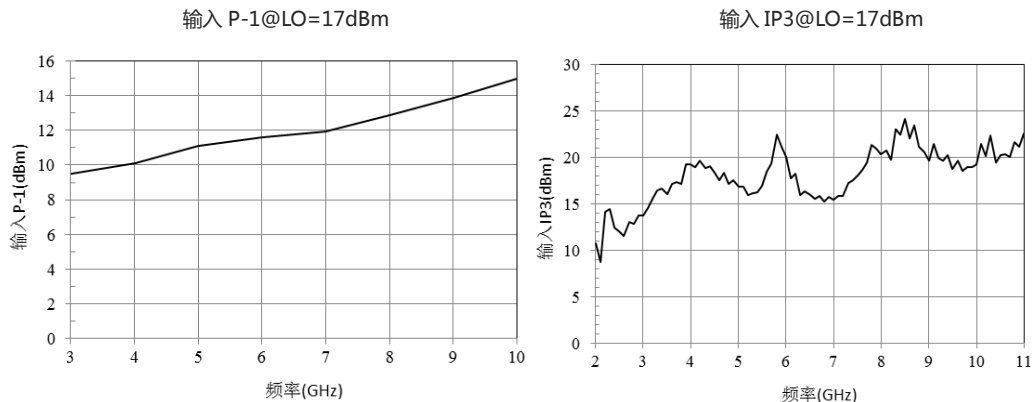
射频回波损耗



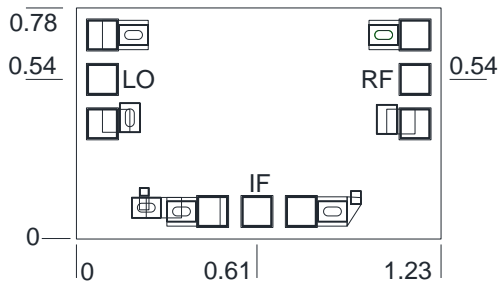
中频回波损耗



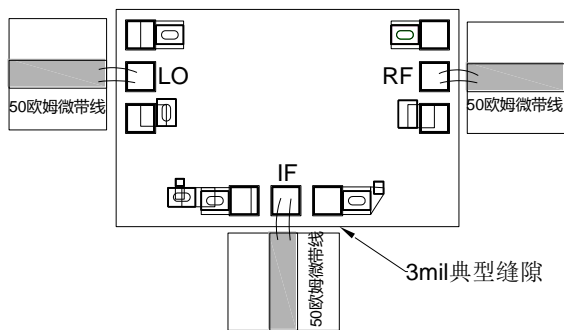
05  
混  
频  
器



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



**使用说明：**

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。